

证券代码：688603

证券简称：天承科技

## 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	南方基金，华夏基金，安信基金，泰康资产，长城基金，平安基金，大成基金，博时基金，浙商证券，中金公司，施罗德投资，太平保险，银河基金，宝盈基金，东方阿尔法，玄元投资，金信基金，瀚伦投资，德懿禾投资，中信证券，中欧基金，工银瑞信，Mellifluous Capital，于翼资产	
调研时间	2024年6月12日-2024年6月13日 2024年6月18日（周二）15:00-16:00	
会议地点	电话会议、策略会	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维	
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司截止目前，2024年的二季度营收情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>得益于下游电子电路行业景气度回升与公司不断的新客户及客户电镀线的拓展，截至目前，公司2024年二季度的销售量呈现不错的增长现象。</p> <p>（二）相较于TSV，TGV的优势体现在哪里，公司关于玻璃基板的TGV电镀液进展情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>TGV在封装领域是指玻璃基材填孔工艺。TGV相较于TSV的优势体现在玻璃基板具有优良的高频电学特性、低成本易于获取、稳定性</p>	

	<p>强等特点，是封装技术的另一场革命。</p> <p>公司前期已有相关玻璃基板通孔填孔的研发和技术储备，已成功开发出用于 TGV 的 SkyFab THF 系列产品，现正把握时机进行下游拓展。公司目前与涉及到玻璃基板的各方展开紧密的接触，积极为各方提供样品打样服务，共同推动行业进步。</p> <p><b>（三）请问公司最近东南亚拓展情况如何？</b></p> <p>答复：</p> <p>公司前期已与下半年将在泰国、马来西亚等地区投产的部分客户进行了充分沟通与接触，相关的前期技术支持、解决方案提供等工作在陆续进行完毕，公司将在前述客户开线投产时向其提供产品及配套技术服务。</p> <p><b>（四）请问公司先进封装领域的电镀添加剂目前验证进展如何？</b></p> <p>答复：</p> <p>公司先进封装的产品主要聚焦于 RDL、bumping、TSV 和 TGV, 其相关的电镀添加剂已经研发完成，并处于下游客户持续验证阶段，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期，后续将接受终端客户的验厂。同时关于大马士革电镀液产品，公司也正在积极研发中。</p> <p><b>（五）请问公司 PCB 领域水平沉铜和电镀的拓展情况如何，如何看待其国产化率的提升？</b></p> <p>答复：</p> <p>PCB 水平沉铜、电镀专用化学品为公司的核心技术产品，公司正不断扩大其于下游客户的应用，随着技术的不断积累和更多客户的认可，目前公司水平沉铜和电镀产品拓展增速呈现较好趋势。上述产品的国产化率较低，主要由陶氏杜邦、安美特、JCU、麦德美乐思等外资企业占据市场。公司将不断自主创新实现进口替代，推动高端功能性湿电子化学品国产化率提升，解决关键“卡脖子”问题。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 20 日